

证券代码： 002156

证券简称：通富微电

通富微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2024 年度业绩网上说明会的投资者
时间	2025 年 4 月 18 日 (周五) 下午 15:00~17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	公司董事长兼总裁石磊、董事兼副总裁夏鑫、独立董事沈小燕、董秘蒋澍、财务总监陶翠红
投资者关系活动主要内容介绍	与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的主要问题进行了答复： 1、麻烦说下 2025 年的公司增长点，以及关税带来的影响？ 尊敬的投资者，您好！IDC 预计，2025 年全球半导体市场将呈现八大趋势，其中与封测有关的是：封测产业生态重塑，中国大陆市场份额将持续扩大；先进封装方面，扇外型面板级封装（FOPLP）深入布局，CoWoS 产能倍增。从应用端看，AI 终端多面渗透，多场景驱动需求升级；从产业端看，封测技术突破瓶颈，技术创新与市场需求双轮驱动。总体来看，2025 年封测行业将在技术创新与市场需求共振中迈向更高台阶，先进封装与国产替代仍是核心主线。公司将积极把握上述行业趋势，2025 年，公司营收目标为 265.00 亿元，较 2024 年增长 10.96%。通富微电是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。截至目前，美国提出的对等关税范围中不包括半导体。经初

步评估，美国政府的对等关税政策目前对于公司基本无直接影响。考虑到未来美国对半导体行业的关税政策仍存在不确定性，公司将密切关注关税政策后续发展情况及产生的潜在影响，开展风险评估，并积极采取应对举措。谢谢关注！

2、请问下 2025 年公司高管和大股东可有增持自己公司股份的计划？

尊敬的投资者，您好！感谢您的关注，公司高管及大股东如有增持计划，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。谢谢！

3、2025 年第一季度财报什么时候出呢？

尊敬的投资者，您好！公司计划于 2025 年 4 月 30 日披露 2025 年一季报。谢谢关注！

4、贵公司如何看待半导体封装测试行业未来的发展趋势？例如，随着 5G、人工智能、物联网等新兴技术的发展，对封装测试技术的需求将如何变化？贵公司是否有针对性的应对措施？

尊敬的投资者，您好！你这问题很好。从半导体封测行业来看，随着异构集成需求增加、Chiplet 商业化落地以及高密度互连与散热的挑战，先进封装技术将成为行业核心驱动力之一。5G、人工智能、物联网等新兴技术的发展，也会推动先进封装技术应用，包括 SIP、WLP 等等。公司在发展过程中不断加强自主创新，取得了丰硕的技术创新成果。同时，面向未来高附加值产品以及市场热点方向，大力开发扇外型、圆片级、倒装焊等封装技术并扩充其产能；此外，积极布局 Chiplet、2D+等顶尖封装技术，形成了差异化竞争优势。谢谢关注！

5、公司业务出口占比较高，目前美国大幅提高关税，请问这种情况下对公司经营有影响吗？

尊敬的投资者，您好！通富微电是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服

务。截至目前，美国提出的对等关税范围中不包括半导体。经初步评估，美国政府的对等关税政策目前对于公司基本无直接影响。考虑到未来美国对半导体行业的关税政策仍存在不确定性，公司将密切关注关税政策后续发展情况及产生的潜在影响，开展风险评估，并积极采取应对举措。谢谢关注！

6、公司今年分红吗？

尊敬的投资者，您好！公司分红方案如下：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 1,517,596,912 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），本次不进行资本公积转增股本，不送红股。公司本次拟派发现金红利 68,291,861.04 元（含税）。董事会、股东大会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，如享有利润分配权的股份总数发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配比例不变的原则进行调整。

7、公司间接投资 AAMI 的进展如何？

尊敬的投资者，您好！公司已分别受让滁州广泰和嘉兴景曜的合伙份额，以间接持有引线框架供应商 AAMI 股权；此外，公司与至正股份（SH：603991）签署了《资产购买协议》及相关《补充协议》，至正股份拟发行股份购买公司持有的滁州广泰和嘉兴景曜的合伙份额。截至目前，至正股份本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜，已获得上交所受理并依法进行审核。如发行股份购买资产并募集配套资金事宜获得审核通过，公司将直接持有至正股份股票，仍继续间接持有 AAMI 股权，在进一步提高公司供应链的稳定性和安全性的同时，至正股份股票具有更高的流动性，有利于公司实现投资收益，符合公司利益和发展战略。谢谢！

8、请问公司 2024 年在先进封装产品方面的发展情况如何？

尊敬的投资者，您好！2024 年，公司与国际大客户的合

	作关系愈发紧密，凭借多年来与国际大客户等行业领军企业携手合作所积累的深厚经验，公司在通富超威槟城成功布局先进封装业务，建设 Bumping、EFB 等生产线。此举精准契合国际大客户的经营战略，有效助力公司在先进封装领域进一步提升市场份额。谢谢关注！ 9、公司 2025 年有什么投资计划？ 尊敬的投资者，您好！公司及下属控制企业南通通富、合肥通富、通富通科、通富超威苏州及通富超威槟城等计划 2025 年在设施建设、生产设备、IT、技术研发等方面投资共计 60 亿元。谢谢关注！ 10、尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1、过往几年的年报显示，去年业绩有了很大的增长，但从公司历年融资和分红看，体现融资高分红少，能否分析一下其中的原因？如何增加对股东的回报？2、公司今年在市值管理上会做哪些工作？投资者关系和媒体关系上会做哪些突破？3、请简要介绍一下关税和贸易战对本行业、公司的影响及目前的应对举措。 尊敬的投资者，您好！感谢您对通富微电的关注！相关问题回复如下： 1. 公司所处的集成电路封测行业属于重资产商业模式，需要根据行业发展趋势及市场需求保持合理的资本开支。随着公司营业收入规模的持续提升以及相关市场的加速布局，公司需要留存一定的资金以满足公司投资建设、日常经营、业务开展的需求，保障公司可持续发展并提升公司防范相关风险的能力。公司始终坚持脚踏实地做好封测主营业务，希望抓住集成电路行业发展机遇，通过提升经营业绩，回报广大投资者。 2. 2025 年 4 月 10 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《市值管理制度》。该制度的制定，有利于我们更加系统化的做好市值管理工作。今后，我们将按照《市
--	---

	值管理制度》的要求，开展相关工作，提升公司投资价值和股东回报能力。 3. 通富微电是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。截至目前，美国提出的对等关税范围中不包括半导体。经初步评估，美国政府的对等关税政策目前对于公司基本无直接影响。考虑到未来美国对半导体行业的关税政策仍存在不确定性，公司将密切关注关税政策后续发展情况及产生的潜在影响，开展风险评估，并积极采取应对举措。 11、公司收购京隆科技 26 股权一事的进展如何？ 尊敬的投资者，您好！感谢对通富微电的关注！2024 年，公司与相关方签订《股权买卖协议》，以自有资金收购京隆科技 26%股权，京隆科技运营模式和财务状况良好，其在高端集成电路专业测试领域具备差异化竞争优势。公司已于 2025 年 2 月 13 日完成交割并支付了相关股权购买价款，公司收购京隆科技部分股权可提高公司投资收益，为公司带来稳定的财务回报，为全体股东创造更多价值。谢谢！ 12、公司 2024 年有什么重大工程的建设吗？ 尊敬的投资者，您好！2024 年，南通通富三期工程、通富通科、通富通达、通富超威苏州、通富超威槟城新工厂等一批公司重大项目建设稳步推进，施工面积合计约 24.45 万平米，产能布局持续优化。公司持续推进重大项目建设，确保满足当前及未来的生产运营需求，不断增强企业发展的内生动力和可持续性。 谢谢关注！ 13、公司 2024 年度的筹资活动现金流出小计为 11,803,955,064.90 元，较上年度有所增加，请问这些资金的主要用途是什么？公司如何确保资金的有效利用？ 尊敬的投资者，感谢对于通富微电的关注。24 年度筹资活动现金流出主要用于偿还债务支付的现金 109.8 亿，分配
--	---

	股利、利润或偿付利息支付的现金 5.4 亿，支付其他与筹资活动有关的现金 2.8 亿。资金是关系到公司持续性运营的重要支撑因素，公司在资金优化方面采取了如下措施：一、营运资本管理优化，1) 加强应收账款管理，优化信用政策，应收账款周转天数从 24 年期初 77 天缩短至期末的 52 天；2) 优化存货管理，建立合理、健全的仓储管理制度。存货周转天数从 24 年期初 75 天缩短至期末的 42 天；二、现金流精细化管理；三、融资结构优化，24 年度财务费用降低 7000 多万。 14、对于讨论度很高的 AI 终端应用，公司对于未来发展趋势怎么看？ 尊敬的投资者，您好！根据相关预测，2025 年，人工智能技术从云端向终端的加速迁移成为半导体行业核心增长引擎。消费电子智能化迭代方面：生成式 AI 技术推动智能手机功能重构，根据 IDC 预测，全球生成式 AI 智能手机的出货量在 2023 年至 2028 年的 CAGR 将达到 78.4%，2028 年出货量将增长至 9.12 亿部。AI PC 市场同样迎来爆发，随着大模型计算负载部分下沉至本地，个人大模型的需求日益增长，其普惠要求正契合 PC 端优势。据 IDC 预测，至 2028 年预计 AI PC 渗透率 98%。可穿戴设备不断创新，AI 耳机、AI 眼镜等产品成为新增长点。汽车与工业领域应用方面：随着自动驾驶等级提升，车载 AI 芯片需求激增，用于处理激光雷达、摄像头等多源数据。AI 算法与边缘计算结合，推动工厂设备智能化升级，如机械臂自主决策、质量检测视觉系统等，带动工业芯片需求逐步复苏。总之，AI 终端应用的蓬勃发展将为半导体行业的持续增长注入源源不断的动力。 15、请介绍通富微电 2024 年营收及归母净利润情况？ 尊敬的投资者，感谢对于通富微电的关注。2024 年，公司扬长补短，积极调整产能布局，不断技术创新，加强管理，持续服务好大客户，苏州工厂与槟城工厂不断强化与国际大
--	--

	客户等行业领先企业的深度合作，进一步扩大先进产品市占率，在品质提升、技术研发、新工厂建设、营运及人才融合等方面收获良好的效益；集团内其他工厂不断完善运行机制，提升质量水平，推动人才梯队建设，狠抓降本工作，倾力打造核心竞争力。2024 年，公司实现营业收入 238.82 亿元，同比增长 7.24%。根据芯思想研究院发布的 2024 年全球委外封测榜单，公司在全球前十大封测企业中排名不变。 2024 年，公司实现归属于母公司股东的净利润 6.78 亿元，同比增长 299.90%。2024 年，半导体行业逐步进入周期上行阶段，在行业去库存逐步到位，数据中心、汽车电子等行业需求拉动以及消费电子产品政策利好的共同作用下，市场需求逐渐回暖。同时，人工智能在 PC 端的蓬勃发展有望带动半导体行业进一步向上增长。报告期内，得益于公司战略精准定位和经营策略的有效执行，公司市场开拓卓有成效，产品结构得以进一步优化，产能利用率提升，营业收入增长，特别是中高端产品营业收入增加明显。同时，通过加强管理及成本费用的管控，公司整体效益显著提升，全方位推动公司高质量发展。 16、请问公司计划如何优化资金周转效率？ 尊敬的投资者，感谢对于通富微电的关注。资金是关系到公司持续性运营的重要支撑因素，公司在资金优化方面采取了如下措施：一、营运资本管理优化，1) 加强应收账款管理，优化信用政策，应收账款周转天数从 24 年期初 77 天缩短至期末的 52 天；2) 优化存货管理，建立合理、健全的仓储管理制度。存货周转天数从 24 年期初 75 天缩短至期末的 42 天；二、现金流精细化管理；三、融资结构优化，24 年度财务费用降低 7000 多万； 17、公司有什么技术优势吗？ 尊敬的投资者，您好！作为国家高新技术企业，公司先后承担了多项国家级技术改造、科技攻关项目，并取得了丰
--	---

	硕的技术创新成果：大尺寸多芯片 Chiplet 封装取得重要优化进展，通过改进封装结构设计和材料工艺，成功提升了封装密度、散热性能和整体可靠性；FCCSP SOC 电容背贴产品通过考核并进入量产等。公司在发展过程中不断加强自主创新，并在多个先进封装技术领域积极开展国内外专利布局。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计国内外专利申请达 1,656 件，其中发明专利占比约 70%；同时，公司先后从富士通、卡西欧、AMD 获得技术许可，使公司快速切入高端封测领域，为公司进一步向高阶封测迈进，奠定坚实的技术基础。感谢您的关注！ 18、领导，您好！我来自四川大决策 请问贵公司与 AMD 深度绑定,2024 年净利润增长超 20 倍。能否介绍在马来西亚、合肥等基地的扩产计划？除 AMD 外，是否与国内 AI 芯片厂商（如华为昇腾）展开合作？ 尊敬的投资者，您好！通过并购，公司与 AMD 形成了“合资+合作”的强强联合模式，建立了紧密的战略合作伙伴关系。公司计划 2025 年在设施建设、生产设备、IT、技术研发等方面投资共计 60 亿元。其中：崇川工厂、南通通富、合肥通富、通富通科等计划共计投资 25.00 亿元；通富超威苏州、通富超威槟城等计划共计投资 35.00 亿元。公司主营集成电路封装测试业务，公司客户资源覆盖国际巨头企业以及各个细分领域龙头企业，大多数世界前 20 强半导体企业和绝大多数国内知名集成电路设计公司都已成为公司客户。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 04 月 18 日